

关于深圳精智达技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函中有关财务事项的说明

大华核字[2026] 0011006459 号

上海证券交易所：

《关于深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕69号）（以下简称“审核问询函”）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳精智达技术股份有限公司（以下简称精智达、公司或发行人）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下：

如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。

本问询函回复除特别说明外数值保留2位小数，若出现总数与各项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1、关于募投项目与融资规模

根据申报材料：（1）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 295,900.00 万元，用于半导体存储测试设备产业化智造项目、半导体存储测试设备技术研发项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目、补充流动资金；（2）公司具有轻资产、高研发投入的特点。

请发行人在募集说明书中按照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 4 条规定补充披露募投项目用地进展等情况。

请发行人：（1）本次募投项目与前次募投项目及现有业务的区别与联系，本次募投项目开展半导体存储测试设备研发及产业化的主要考虑及必要性、紧迫性；半导体存储测试设备产业化智造项目是否涉及新产品，是否符合投向主业相关要求；（2）结合公司研发模式、本次募投项目具体研发内容及与现有业务的协同性、研发成果预计转化情况、当前研发进展及后续安排、人才及技术储备、研发难点的攻克情况、客户开发认证情况、原材料及设备采购等，说明实施本次募投项目的可行性；（3）结合本次募投各产品的市场需求及竞争格局、公司竞争优势、公司现有及规划产能、同行业可比公司扩产情况、产能利用率、产销率、在手订单及意向订单等，说明本次募投项目产能规划合理性以及产能消化措施；（4）前次募投项目新一代显示器件检测设备研发项目、先进封装设备研发项目的具体投向及后续研发安排，前次募投项目延期的具体原因，是否影响本次再融资实施，相关研发进展是否符合预期；（5）本次募投项目各项投资支出的具体构成及测算依据、非资本性支出构成情况，并结合持有货币资金、交易性金融资产等情况，说明本次融资规模的合理性；（6）本次募投项目效益测算中产品单价、销量、毛利率等指标选取的主要依据，与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异，本次效益测算是否谨慎、合理。

请保荐机构对上述问题进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题（5）（6）进行核查并发表明确意见，请保荐机构及发行人律师对募投项目用地取得情况进行核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

(一) 本次募投项目各项投资支出的具体构成及测算依据、非资本性支出构成情况，并结合持有货币资金、交易性金融资产等情况，说明本次融资规模的合理性

1、本次募投项目各项投资支出的具体构成及测算依据

2026年5月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等议案，公司将本次募投项目拟募集资金调整至285,658.00万元，涉及半导体存储测试设备研发及产业化智造项目（包括半导体存储测试设备产业化智造项目、半导体存储测试设备技术研发项目两个子项目）、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目、补充流动资金，具体情况如下：

(1) 半导体存储测试设备产业化智造项目

本项目规划总投资金额44,096.00万元，其中拟投入募集资金39,468.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	场地投资	25,982.00	58.92%	23,305.85	59.05%
2	设备投资	8,858.00	20.09%	7,945.63	20.13%
3	预备费	1,742.00	3.95%	1,562.57	3.96%
4	铺底流动资金	7,514.00	17.04%	6,653.95	16.86%
合计		44,096.00	100.00%	39,468.00	100.00%

①场地投资

本项目场地投资为25,982.00万元，其中土地投资为1,232.00万元、工程建设投资为24,750.00万元，具体情况如下：

A.土地投资

半导体存储测试设备研发及产业化智造项目涉及半导体存储测试设备产业化智造项目、半导体存储测试设备技术研发项目两个子项目，位于同一宗土地上，总用地面积为 11,000.00 平方米，预计土地购置费用为 1,320.00 万元，土地购置折合单价预计为 0.12 万元/平方米，主要系结合当地土地供应价格及募投用地区域情况等因素综合考虑预估。

半导体存储测试设备研发及产业化智造项目总建筑面积 41,800.00 平方米，子项目土地购置费用系根据项目规划建筑面积进行分摊，具体如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

项目名称		规划建筑面积 (平方米)	土地购置费 (万元)
半导体存储测试设备研发及产业化智造项目	半导体存储测试设备产业化智造项目	39,000.00	1,232.00
	半导体存储测试设备技术研发项目	2,800.00	88.00
	合计	41,800.00	1,320.00

由上可见，本项目土地投资费用为 1,232.00 万元。

公司本项目土地投资购置单价与所在位置周边同类型土地交易价格对比情况如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	项目方	地址	土地面积	购置单价	总价
1	深圳市英维克科技股份有限公司	深圳龙华区观澜街道	18,119.52	0.13	2,400.00
2	发行人	深圳龙华区观澜街道	11,000.00	0.12	1,320.00

注：数据来源于深圳公共资源交易中心

B. 工程建设费用

本项目工程建设投资主要包括建筑工程施工费用、工程建设其他费用等，具体情况如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	项目	规划建筑面积	建造造价	总价
1	生产区域			
1.1	生产车间	25,000.00	0.64	16,000.00
1.2	仓库	5,000.00	0.48	2,400.00

序号	项目	规划建筑面积	建造造价	总价
2	配套建筑区域	6,000.00	0.55	3,300.00
3	行政办公区域	3,000.00	0.65	1,950.00
4	地下建筑区域	1,000.00	0.50	500.00
5	工程建设其他费用	/	/	600.00
合计		40,000.00	-	24,750.00

由上可见，本项目拟新建生产区域、配套建筑区域、行政办公区域等，配套建筑区域主要包括员工食堂、员工公寓等。

建筑工程施工费用根据建筑面积及单位造价确定，具体建筑面积系公司结合募投项目相关生产、原材料及产成品仓储等所需场地空间，并综合考虑辅助生产设施、相关人员的办公场所等所需空间确定；单位造价根据市场类似工程相关技术经济指标以及本项目实际建设需求进行合理估算。

工程建设其他费用主要涉及建筑设计费、监理费等，系公司根据市场公开价格及项目实际情况等因素进行合理估算。

本项目工程建设费用与半导体设备行业上市公司类似项目对比情况如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

公司名称	项目名称	规划建筑面积	建筑投资总额	单位造价
中微公司	中微临港产业化基地	180,000.00	140,000.00	0.78
中科飞测	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	98,743.62	65,501.63	0.66
本项目		40,000.00	24,750.00	0.62

注：建筑投资总额包含工程建筑其他费用。

由上可见，本项目与半导体设备行业上市公司类似项目单位造价相比不存在显著差异，具有合理性。

②设备投资

本项目设备投资金额为 8,858.00 万元，其中硬件设备投资金额 7,558.00 万元，软件设备投资金额 1,300.00 万元，具体构成如下：

序号	具体项目	金额	占比
1	硬件设备购置费	7,558.00	85.32%
2	软件购置费	1,300.00	14.68%
合计		8,858.00	100.00%

其中，单项采购预算金额超过 400 万元的购置情况如下：

单位：台/套、万元

序号	名称	数量	单价	预算金额
1	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	1,800.00
2	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	1,200.00
3	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	880.00
4	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	880.00
5	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	500.00
6	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	500.00
7	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	468.00
8	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	400.00
9	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	400.00
合计				7,028.00
占比				79.34%

本项目生产相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有生产设备情况等因素进行合理估算，价格测算依据主要系参考公司同类或相似设备历史采购价格或自建价格、供应商询价以及市场公开价格等因素进行合理估算。

③预备费及铺底流动资金

本项目预备费按照场地投资与设备投资费用合计金额的 5% 计算，即 1,742.00 万元；铺底流动资金按照项目计算期经营周转所需营运资金的 10% 计算，即 7,514.00 万元。

(2) 半导体存储测试设备技术研发项目

本项目计划投资总额 38,124.00 万元，其中拟投入募集资金 38,100.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	场地投资	1,958.00	5.14%	1,958.00	5.14%
2	设备投资	2,145.00	5.63%	2,145.00	5.63%
3	研发费用	34,021.00	89.24%	33,997.00	89.23%
合计		38,124.00	100.00%	38,100.00	100.00%

①场地投资

本项目场地投资为 1,958.00 万元，其中土地投资为 88.00 万元、工程建设投资为 1,870.00 万元，具体情况如下：

A.土地投资

本项目土地投资金额 88.00 万元，本项目和半导体存储测试设备产业化智造项目位于同一宗土地上，用地面积系根据项目规划建筑面积进行分摊。本项目土地投资用地土地购置折合单价与半导体存储测试设备产业化智造项目相同，主要系结合当地土地供应价格及募投用地区域情况等因素综合考虑预估，具备合理性。

B.工程建设费用

本项目工程建设投资主要包括建筑工程施工费用、工程建设其他费用等，具体情况如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	项目	规划建筑面积	建造造价	总价
1	研发实验测试区域	500.00	0.65	325.00
2	研发办公区域	2,300.00	0.65	1,495.00
3	建筑工程其他费用	/	/	50.00
合计		2,800.00	-	1,870.00

由上可见，本项目拟新建研发实验测试区域、研发办公区域等。其中，建筑工程施工费用根据建筑面积及单位造价确定，具体建筑面积系公司结合研发活动

所需场地空间，并综合考虑相关人员的办公场所等所需空间确定；单位造价根据市场类似工程相关技术经济指标以及本项目实际建设需求进行合理估算。

工程建设其他费用主要涉及建筑设计费、监理费等，系公司根据市场公开价格及项目实际情况等因素进行合理估算。

本项目工程建设费用与半导体设备行业上市公司类似项目对比情况如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

公司名称	项目名称	规划建筑面积	建筑投资总额	单位造价
中微公司	中微临港总部和研发中心项目	105,000.00	108,000.00	1.03
中科飞测	上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	47,723.08	22,901.09	0.48
	总部基地及研发中心升级建设项目	47,500.51	39,116.60	0.82
本项目		2,800.00	1,870.00	0.67

注：建筑投资总额包含工程建筑其他费用。

由上可见，本项目与半导体设备行业上市公司类似项目单位造价相比处于合理区间内，不存在显著差异，具有合理性。

②设备投资

本项目设备投资金额为 2,145.00 万元，其中硬件设备投资金额 1,715.00 万元，软件设备投资金额 430.00 万元，具体构成如下：

序号	具体项目	金额	占比
1	硬件设备购置费	1,715.00	79.95%
2	软件购置费	430.00	20.05%
合计		2,145.00	100.00%

其中，单项采购预算金额超过 400 万元的购置情况如下：

单位：台/套、万元

序号	名称	数量	单价	预算金额
1	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	1,400.00
2	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	400.00
合计				1,800.00

序号	名称	数量	单价	预算金额
占比				83.92%

本项目研发相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有生产设备情况等因素进行合理估算，价格测算依据主要系参考公司同类或相似设备历史采购价格、供应商询价以及市场公开价格等因素进行合理估算。

③研发费用

本项目研发费用为建设期内开展研发活动所需研发人员薪酬、研发材料费及其他研发费用等，共计 34,021.00 万元。

A.研发人员薪酬

本项目研发人员薪酬主要由研发人员数量及人均薪酬构成。研发人员数量主要系根据研发规划预估研发投入人员数量。研发人员薪酬主要系根据公司历史研发人员薪酬水平、项目所在地区人均薪酬水平等因素进行合理估算。2023 年度至 2025 年度公司研发人员人均薪酬为 24.31 万元/年，本项目研发人员人均薪酬与公司历史年度水平不存在重大差异，具有合理性。

B.研发材料费用及其他研发费用

本项目研发材料费用、其他研发费用（差旅费、技术开发费、测试/认证费用、专利费等）主要系综合考虑公司历史研发费用结构、研发项目实际需要进行合理估算，具体明细如下：

单位：万元

项目	金额	占本次拟投入研发费用的比例
研发材料费用	6,300.00	18.52%
其他研发费用	4,250.00	12.49%
合计	10,550.00	31.01%

2023 年度至 2025 年度公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	平均占比
研发费用	18,311.81	10,968.77	7,185.00	

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	平均占比
其中：研发材料费用	3,176.85	1,023.94	987.27	13.48%
其他研发费用	2,229.21	1,735.88	1,116.94	14.52%

注：其他研发费用不包含股份支付、折旧摊销费用

由上可见，本项目研发材料费用、其他研发费用占拟投入的研发费用比例与公司历史研发费用结构不存在重大差异，符合公司实际情况，具有合理性。

(3) 高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目

本项目计划投资总额 158,800.00 万元，其中拟投入募集资金 153,800.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	场地投资	7,390.00	4.65%	7,390.00	4.80%
2	设备投资	14,922.00	9.40%	14,922.00	9.70%
3	研发费用	136,488.00	85.95%	131,488.00	85.49%
合计		158,800.00	100.00%	153,800.00	100.00%

①场地投资

本项目拟在上海租赁 8,800.00 平方米研发办公场地，场地投资主要为场地租赁费用和场地装修费。

本项目场地租赁费用为项目投资期租金费用，合计 4,750.00 万元，租赁单价系根据初步协商价格进行合理估算。本项目实施地点位于上海市浦东新区金桥装备小镇。根据高力国际出具的《上海产业园区市场回顾与展望报告》，2025 年第四季度康桥镇产业园区平均租金约为 2.64 元/平方米/天，与本项目租赁单价不存在重大差异，具有合理性。

本项目场地装修费用为 2,640.00 万元，系结合公司募投场地的研发需求、当地市场情况及建设经验等因素进行合理估计。

②设备投资

本项目设备投资金额为 14,922.00 万元，其中硬件设备投资金额 5,946.00 万

元，软件设备投资金额 8,976.00 万元，具体构成如下：

序号	具体项目	金额	占比
1	硬件购置费	5,946.00	39.85%
2	软件及 IP 购置费	8,976.00	60.15%
合计		14,922.00	100.00%

其中，单项采购预算金额超过 400 万元的购置情况如下：

序号	名称	数量	单价	预算金额
1	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	5,250.00
2	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	2,500.00
3	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	1,400.00
4	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	800.00
5	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	400.00
6	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	400.00
7	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	400.00
合计				11,150.00
占比				74.72%

本项目研发相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有生产设备情况等因素进行合理估算，价格测算依据主要系参考公司同类或相似设备历史采购价格、供应商询价以及市场公开价格等因素进行合理估算。

③研发费用

本项目研发费用为建设期内开展研发活动所需研发人员薪酬、研发材料费及其他研发费用等，共计 136,488.00 万元。

A.研发人员薪酬

本项目研发人员薪酬主要由研发人员数量及人均薪酬构成。研发人员数量主要系根据研发规划预估研发投入人员数量。研发人员薪酬主要系根据公司历史研发人员薪酬水平、项目所在地区人均薪酬水平等因素进行合理估算。2023 年度至 2025 年度公司研发人员人均薪酬为 24.31 万元/年，本项目研发人员人均薪酬

与公司历史年度水平不存在重大差异，具有合理性。

B.研发材料费用及其他研发费用

本项目研发材料费用、其他研发费用（差旅费、技术开发费、测试/认证费用、专利费等）主要系综合考虑公司历史研发费用结构、研发项目实际需要进行合理估算，具体明细如下：

单位：万元

项目	金额	占本次拟投入研发费用的比例
研发材料费用	26,560.00	19.46%
ASIC 流片费用	16,000.00	11.72%
其他研发费用	18,478.00	13.54%
合计	61,038.00	44.72%

2023 年度至 2025 年度公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	平均占比
研发费用	18,311.81	10,968.77	7,185.00	
其中：研发材料费用	3,176.85	1,023.94	987.27	13.48%
其他研发费用	2,229.21	1,735.88	1,116.94	14.52%

注：其他研发费用不包含股份支付、折旧摊销费用

由上可见，本项目研发材料费用、其他研发费用占拟投入的研发费用比例与公司历史研发费用结构不存在重大差异，符合公司实际情况，具有合理性。

2、本次募投项目非资本性支出构成情况

公司本次募投项目非资本性支出构成情况如下：

单位：万元

项目	序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	是否属于资本性支出	其中：非资本性支出金额
半导体存储测试设备产业化智造项目	1	场地投资	25,982.00	23,305.85	是	-
	2	设备投资	8,858.00	7,945.63	是	-
	3	预备费	1,742.00	1,562.57	否	1,562.57

项目	序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	是否属于资本性支出	其中：非资本性支出金额
	4	铺底流动资金	7,514.00	6,653.95	否	6,653.95
	小计		44,096.00	39,468.00		8,216.52
半导体存储测试设备技术研发项目	1	场地投资	1,958.00	1,958.00	是	-
	2	设备投资	2,145.00	2,145.00	是	-
	3	研发费用	34,021.00	33,997.00	否	33,997.00
	小计		38,124.00	38,100.00		33,997.00
高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目	1	场地投资	7,390.00	7,390.00	是	-
	2	设备投资	14,922.00	14,922.00	是	-
	3	研发费用	136,488.00	131,488.00	否	131,488.00
	小计		158,800.00	153,800.00		131,488.00
补充流动资金		54,290.00	54,290.00	否	54,290.00	
合计			295,310.00	285,658.00		227,991.52

本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，非资本性支出合计拟使用募集资金 227,991.52 万元，占募集资金总金额的比例为 79.81%，其中非研发投入费用占比为 21.88%，与主营业务相关的研发投入费用占比为 57.93%，符合《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号—轻资产、高研发投入认定标准（2026 年修订）》的相关要求，即超过募集资金总金额 30% 的部分均会被用于主营业务相关的研发投入。

3、结合持有货币资金、交易性金融资产等情况，说明本次融资规模的合理性

（1）公司持有的货币资金、交易性金融资产情况

报告期各期末，公司持有的货币资金、交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	70,410.30	50,877.77	74,062.74
交易性金融资产	25,039.33	7,009.68	30,056.61

报告期内，公司货币资金主要为银行存款（含前次募集资金）及其他货币资金（主要为履约保证金及票据保证金）；交易性金融资产主要为银行结构性存款等理财产品。

（2）公司资金缺口情况

综合考虑公司可自由支配资金余额、未来期间经营活动现金流量净额及各项资金需求安排等，公司未来三年总体资金缺口的具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
截至 2025 年 12 月 31 日货币资金、交易性金融资产及大额存单余额	①	116,075.06
其中：受限制的货币资金余额	②	1,008.16
前次募集资金余额	③	49,627.10
可自由支配资金余额	④=①-②-③	65,439.80
未来三年经营活动现金流量净额	⑤	28,386.12
最低现金保有量需求	⑥	71,151.92
未来三年新增最低现金保有量需求	⑦	124,088.95
未来三年预计现金分红所需金额	⑧	6,885.69
已审议的重大投资项目需求	⑨	241,020.00
总体资金需求合计	⑩=⑥+⑦+⑧+⑨	443,146.56
总体资金缺口	⑪=⑩-④-⑤	349,320.64

公司未来三年预计经营利润积累、未来期间经营活动现金流量净额、最低现金保有量等各明细的测算过程如下：

①可自由支配资金余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金、交易性金融资产及大额存单（含在“一年内到期的非流动资产”及“其他非流动资产”中核算的大额存单）合计余额为 116,075.06 万元，其中使用受限的货币资金（如保证金等）1,008.16 万元，前次募集资金未使用资金为 49,627.10 万元，据此测算，公司可自由支配的资金余额为 65,439.80 万元。

②未来三年经营活动现金流量净额

2025 年度，公司营业收入较上年同比增长 40.46%，假设未来三年公司主营业务、经营模式保持稳定，测算时按照营业收入同比增长率 40%作为未来营业收入增长率的测算依据。根据公司报告期内经营性现金流净额占营业收入的比例及公司预测的收入增速测算的未来三年营业收入，公司未来三年经营性现金流净额为 28,386.12 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
报告期内营业收入总和	①	257,975.42
报告期内经营性现金流净额	②	10,634.99
经营性现金流净额占营业收入比例	A=②/①	4.12%
未来三年营业收入总和	B	688,568.51
未来三年经营性现金流净额	C=A×B	28,386.12

注：未来三年指 2026 年-2028 年，下同。

③最低现金保有量

最低现金保有量系公司为维持其日常营运所需要的最低货币资金。按照经营性现金流出月度覆盖法则测算最低现金保有量，报告期各期，公司经营性现金流出情况如下：

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年
货币资金、交易性金融资产及大额存单余额	118,029.65	122,424.37	116,075.06
受限或无法使用的部分	596.81	456.84	1,008.16
前次募集资金余额	75,022.74	67,316.14	49,627.10
期末可自由支配资金余额	42,410.10	54,651.39	65,439.80
购买商品、接受劳务支付的现金	42,376.14	41,339.68	73,103.47
支付给职工以及为职工支付的现金	10,129.32	13,665.51	17,954.13
支付的各项税费	4,058.54	4,256.21	6,676.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,196.71	6,817.42	8,993.94

项目	2023 年	2024 年	2025 年
经营活动现金流出小计	64,760.71	66,078.82	106,727.89
月均经营活动现金流出	5,396.73	5,506.57	8,893.99
覆盖月份数	7.86	9.92	7.36
覆盖月份数平均值	8.38		

结合公司日常经营收支情况等要素，按照覆盖月份平均值取整的 8 个月作为最低现金保有量测算的覆盖月份数，则截至 2025 年末，公司最低现金保有量为 71,151.92 万元。

④未来三年新增最低现金保有量需求

公司最低现金保有量与公司经营规模高度相关。假设公司未来三年营业收入按照 40% 的速度增长，未来三年最低现金保有量在 2025 年末的基础上按同比例增长，据此计算的未来三年新增最低现金保有量为 124,088.95 万元。具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	计算结果
2025 年末最低现金保有量	①	71,151.92
营业收入假设增长率	②	40.00%
2028 年末最低现金保有量	③=①*(100%+②)^3	195,240.88
未来三年新增最低现金保有量	④=③-①	124,088.95

⑤未来三年预计现金分红所需金额

根据经营业绩测算以及《公司章程》涉及的分红比例的相关情况，公司预计未来三年现金分红所需金额为 6,885.69 万元。

⑥已审议的重大投资项目需求

截至本回复出具日，公司当前已经董事会审议的重大投资项目需求为本次募集资金投资项目。仅考虑项目建设投资，本次募投项目所需总投资金额为 241,020.00 万元，分别为半导体存储测试设备研发及产业化智造项目拟投资 82,220.00 万元和高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目拟投资 158,800.00

万元。

因此，综合考虑上述因素，公司面临的资金缺口为 349,320.64 万元，超过本次发行拟募集资金总额 285,658.00 万元，本次募集资金规模具有合理性。

上述预测仅用于本次公司资金需求测算，并不构成公司的盈利和现金分红预测，不代表对公司未来业绩及分红安排的任何形式的保证与承诺。

(二) 本次募投项目效益测算中产品单价、销量、毛利率等指标选取的主要依据，与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异，本次效益测算是否谨慎、合理

本次募投项目中涉及效益测算的项目为半导体存储测试设备产业化智造项目，该项目税后内部收益率为 18.22%，税后投资回收期为 8.83 年，效益测算中关键指标测算依据及具体过程如下：

1、产品单价

本项目投产产品为半导体存储测试设备，具体包括老化测试及修复设备、晶圆（CP）测试机、成品（FT）测试机等。公司本次募投项目投产产品预测单价主要系根据公司同类或类似产品销售单价及订单价格、市场同类产品价格、下游市场客户需求等因素进行合理估算。

本项目投产产品具体定价及测算依据情况如下：

单位：万元

序号	产品类型	销售单价	在手订单产品售价情况	测算依据
1	半导体存储老化测试及修复设备	已申请豁免披露	已申请豁免披露	结合公司同类产品在手订单价格进行合理预估
2	半导体存储晶圆（CP）测试机	已申请豁免披露	已申请豁免披露	结合公司同类产品在手订单价格进行合理预估
3	半导体存储成品（FT）测试机	已申请豁免披露	已申请豁免披露	结合竞品价格、公司同类产品在手或意向订单价格进行合理预估
4	其他产品类型	已申请豁免披露	已申请豁免披露	结合竞品价格进行合理预估

注 1：订单截至 2026 年 3 月 31 日，价格均为不含税价格

注 2：基于谨慎性考虑，半导体存储其他产品类型产能拟使用自有资金投资建设

由上可见，本项目投产产品价格主要系基于公司同类产品在手订单价格、竞

品价格等因素进行合理估算，具有谨慎性、合理性。

2、产品销量

本项目产品销量系公司综合考虑下游市场需求、市场发展趋势、自身实际经营情况等因素进行合理估算，预计 T+7 年达产，达产后产品销量情况具体如下：

单位：台

序号	产品类型	销量
1	半导体存储老化测试及修复设备	已申请豁免披露
2	半导体存储晶圆（CP）测试机	已申请豁免披露
3	半导体存储成品（FT）测试机	已申请豁免披露
4	其他产品类型	已申请豁免披露
合计		已申请豁免披露

3、毛利率

本项目营业成本包括直接材料、直接人工、折旧摊销费用以及其他制造费用等。直接材料成本主要系综合考虑公司生产情况及本次募投项目实际情况合理估算，直接人工成本主要系综合考虑项目规模所需生产相关人员数量、公司历史薪酬水平及项目所在地区薪酬水平合理估算，折旧摊销费用依据公司会计政策和本项目资产投入情况进行合理估算，其他制造费用主要系综合考虑公司生产情况及本项目实际情况等因素合理估算。

本项目通过营业收入和营业成本的差值计算本项目测算期内的毛利，项目达产期（指计算期第 7 年至第 10 年，下同）平均毛利率为已申请豁免披露，与公司最近三年半导体存储测试设备业务毛利率对比情况如下：

项目	本次募投项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
毛利率	已申请豁免披露	28.26%	32.38%	26.84%

与此同时，公司本次募投项目产品毛利率与同行业可比公司毛利率比较情况不存在显著差异，具体情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长川科技	55.05%	54.85%	56.67%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
华峰测控	73.81%	73.39%	71.19%
华兴源创	46.32%	42.12%	53.88%
精测电子	46.73%	39.97%	47.09%
发行人本次募投项目产品毛利率	已申请豁免披露		

由上可见，公司本次募投项目产品毛利率与同行业可比公司毛利率相比不存在重大异常情况，受产品类型及下游客户群体等因素影响，公司本次募投项目产品毛利率与同行业可比公司相比整体处于合理水平，本次募投项目毛利率水平是谨慎的，具有合理性。

4、项目总体效益情况

本项目整体效益情况如下：

项目	单位	数值
内部收益率（IRR）税后	/	18.22%
净现值（NPV）税后	万元	18,983.40
回收期（税后）（含建设期）	年	8.83
达产后毛利率	/	已申请豁免披露
达产后年均收入	万元	已申请豁免披露
达产后年均净利润	万元	已申请豁免披露

公司本项目与半导体设备行业上市公司类似项目效益比较情况如下：

公司名称	项目名称	毛利率	税后内部收益率	税后静态投资回收期（年）
长川科技	探针台研发及产业化项目	50.00%	12.00%	6.53
精测电子	上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目	54.87%	16.75%	未披露
矽电股份	探针台研发及产业基地建设项目	未披露	25.69%	6.33
深科达	半导体先进封装测试设备研发及生产项目	33.57%	23.51%	5.71
发行人	半导体存储测试设备产业化智造项目	已申请豁免披露	18.22%	8.83

由上可见，公司本次募投项目效益指标与半导体设备行业上市公司类型项目相比不存在显著差异，处于合理区间内，具有谨慎性、合理性。

三、核查情况

（一）核查程序

针对（5）至（6）中事项，我们主要执行了以下核查程序：

1、查阅本次募投项目的可行性研究报告，了解本次募投项目的各项投资支出的具体构成及测算依据，分析本次募投项目投资合理性；了解本次募投项目效益测算中产品单价、销量、毛利率等指标，查阅可比公司类似项目效益测算指标情况，分析本次效益测算是否谨慎、合理；

2、查阅发行人本次募投项目的投资明细表，核查项目具体投资构成和金额明细，复核本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成以及占比情况，核查本次募投项目是否符合监管要求；

3、查阅发行人报告期内主要财务数据、截至报告期期末的货币资金余额和交易性金融资产余额，测算未来三年经营活动现金流量净额、最低现金保有量、未来三年新增最低现金保有量需求、未来三年预计现金分红所需资金等，分析发行人本次募集资金用于补充流动资金的规模的合理性；

4、访谈公司管理层，了解发行人未来货币资金余额的使用计划；了解本次募投项目效益测算关键指标测算依据、测算具体过程，分析本次募投项目效益测算的谨慎性及合理性。

（二）核查意见

经核查，我们认为：

1、本次募投项目各项投资支出的具体构成及测试依据具有合理性，本次融资规模具有合理性，符合公司的实际情况；

2、本次募投项目的效益测算是谨慎的，具有合理性。

2、关于经营情况等

根据申报材料：（1）报告期内，发行人营业收入分别为 64,856.33 万元、80,312.97 万元、112,806.11 万元，净利润分别为 11,568.48 万元、8,016.02 万元、6,542.12 万元；（2）报告期内，公司应收账款账面价值分别为 21,946.76 万元、40,350.14 万元、56,657.51 万元；（3）报告期内，公司存货账面价值分别为 23,757.53 万元、14,284.59 万元、21,001.57 万元。

请发行人说明：（1）结合公司主要产品结构、产销量、毛利率变动等情况，说明报告期内收入增长、净利润下滑的主要原因及合理性，相关因素对公司业绩的持续影响，与同行业可比公司是否存在重大差异；（2）结合应收账款主要客户销售金额、交易内容、信用政策等，说明应收账款规模持续增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄情况、回款情况、同行业可比公司情况等，说明坏账准备计提是否充分；（3）结合存货构成、库龄、订单覆盖率、期后销售情况等，说明公司存货跌价准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异；（4）截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资。

请保荐机构和申报会计师进行核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）结合公司主要产品结构、产销量、毛利率变动等情况，说明报告期内收入增长、净利润下滑的主要原因及合理性，相关因素对公司业绩的持续影响，与同行业可比公司是否存在重大差异

1、结合公司主要产品结构、产销量、毛利率变动等情况，说明报告期内收入增长、净利润下滑的主要原因及合理性

（1）报告期内公司业绩波动情况及主要影响因素

报告期内，公司主要经营业绩情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	112,806.11	80,312.97	64,856.33
毛利润	41,434.14	26,355.18	24,551.79
毛利率	36.73%	32.82%	37.86%
二、期间费用	29,220.42	18,296.71	14,333.39
其中：销售费用	5,410.18	4,139.63	4,928.20
管理费用	6,615.74	3,924.88	3,266.80
研发费用	18,311.81	10,968.77	7,185.00
三、其他损益	-4,803.47	-339.15	2,782.12
其中：信用减值损失	-3,598.60	-1,720.88	-639.87
四、利润总额	6,738.23	7,354.22	12,954.37
五、净利润	7,003.49	7,974.97	11,197.57
六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,887.90	6,885.57	8,434.67

由上可见，报告期内，公司经营规模持续向好，营业收入随着经营规模增长有相应增长。然而，随着公司业务规模增长，期间费用出现上升，其中又以研发费用增长较为显著；与此同时，应收账款余额亦有所增长，进而导致相应的信用减值损失出现增长的情况。在此背景下，研发费用及信用减值损失的增长部分抵消了营业收入增长对净利润的影响，导致公司业绩存在一定波动。

（2）营业收入增长原因及持续性分析

①报告期内，公司业务发展态势良好，半导体存储器件测试设备业务逐步成为公司的核心驱动力

报告期内，公司营业收入分别为 64,856.33 万元、80,312.97 万元及 112,806.11 万元，2023 年度至 2025 年度的复合增长率为 31.88%，营业收入保持持续增长的趋势。

报告期内，公司主营业务收入结构情况如下：

单位：万元、台

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体存储器件测试	62,451.69	55.51%	24,941.78	31.09%	8,291.92	12.81%
新型显示器件检测	50,061.27	44.49%	55,285.31	68.91%	56,462.85	87.19%
合计	112,512.96	100.00%	80,227.09	100.00%	64,754.77	100.00%

由上可见，2024 年度及 2025 年度，公司主营业务收入同比增长 15,472.32 万元及 32,285.87 万元，其中，半导体存储器件测试业务收入金额同比增长 16,649.86 万元及 37,509.91 万元，是报告期内公司营业收入增长的核心驱动力。

报告期内，公司半导体存储器件测试业务呈现出高速增长，主要系半导体存储行业进入了新的市场机遇期，半导体存储器件测试业务市场迎来了旺盛的市场需求。受 AI、HBM 等新兴领域推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，显著提升了存储芯片的集成度与结构复杂度。异构集成与垂直堆叠技术在实现性能跨越的同时，也对测试效率、良率控制提出了更严苛要求。在此背景下，下游客户对高端半导体存储测试设备的需求呈现出快速增长趋势。

受下游旺盛需求的影响，半导体存储器件测试业务出现了高速增长。半导体存储器件测试业务核心产品芯片测试设备产品交付量增加直接推动业务收入逐年提升，半导体存储器件测试业务的增长成为公司营业收入快速增长的主要原因。

与此同时，报告期内，新型显示器件检测业务收入规模总体相对稳定，公司 2025 年度新型显示器件检测业务规模相较于 2023 年度有所下降，主要系受下游消费电子市场景气度影响，客户产线投产进度出现减缓，进而导致公司新型显示器件检测业务收入规模有所降低。随着全球经济环境复苏以及 AI 产业催生的新需求，消费电子市场预计将迎来一轮新的增长。公司新型显示器件检测设备的产量从 2023 年的 952 台增加至 2025 年的 1,779 台，销量亦从 2023 年的 853 台增加至 2025 年的 1,756 台。

综上所述，报告期内，公司营业收入快速增长主要系受半导体存储器件测试

业务增长的快速驱动。

②公司双轮驱动战略持续推动主营业务持续向好并有力支撑公司快速增长

报告期内，公司主营业务发展迅速，系受多种因素的积极影响，该等因素将持续支撑公司业务的进一步发展，具体分析如下：

A. 下游行业景气度持续提升，市场需求稳步扩容

近年来，随着下游人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，我国半导体产业快速发展、晶圆产能持续扩张，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。加之，中国本土半导体设备制造商在过去几年经历了较快发展。但由于我国半导体设备产业整体起步较晚，中国半导体设备市场的国产化率仍处于较低水平，尤其在高端半导体设备领域，进口依赖问题较为严重，国产化率提升空间较大。因此，下游市场需求的增长推动了公司半导体存储测试设备业务收入持续增长，报告期内，公司半导体存储器件测试产品收入金额由 8,291.92 万元增长至 62,451.69 万元，年均复合增长率达 174.44%。

与此同时，近年来，中国大陆新型显示器件检测设备市场规模稳定增长，根据 QY Research 调研，2024 年全球平板显示检测设备市场销售额达到了 12.37 亿美元，预计 2031 年市场规模将为 16.14 亿美元，2025~2031 期间年复合增长率（CAGR）为 4.2%。显示检测设备行业发展受下游面板厂新增产线投资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资影响较大，近年来，随着日韩和中国台湾厂商、以及以京东方为代表的国产面板厂商转变策略关闭低世代生产线，中国大陆高世代产线陆续释放产能，全球面板产能进一步向中国大陆集聚，未来新型显示技术的发展将进一步带动新型显示器件检测行业的快速发展，亦为新型显示器件检测设备行业带来增量发展空间。

B. 公司在细分领域持续实现突破并形成市场优势地位

依托在半导体存储测试领域多年深耕与自主创新，公司在海量通道高速信号连接、高精度时序信号生成及驱动、DRAM 测试及修复算法、宽温区高均匀度老化控制等关键领域形成深厚技术积累，产品创新持续取得突破进展，已形成覆盖半导体存储器测试领域关键设备与配套治具的完整产品线，是国内少数实现半导

体存储器测试设备全覆盖的厂商，助力我国半导体产业链关键生产环节自主可控。报告期内，公司核心产品线多项关键性能指标达到国际先进水平，具备参与高端测试设备市场竞争的技术基础与能力。

在新型显示器件检测业务领域，公司致力于加速关键产品的国产化替代进程，并持续深化自主技术创新。在柔性 AMOLED 领域，公司核心产品已在包括多家国内主流新型显示器件厂商制造产线批量应用，涵盖从 Cell 段到 Module 段所有的检测设备，市占率持续提升；在中尺寸 AMOLED 领域，公司加快推进技术的更新迭代与创新研发，在车载、笔电、折叠屏等领域快速适配客户新需求，积极研发可适用于 G8.6 AMOLED 产线的 Cell 及 Module 相关检测设备，积极参与主要客户新产线相关需求产品的技术验证测试和设备评估，并取得了批量订单；在微显示领域，公司与国内外行业龙头企业保持良好的业务关系，开发出用于 Micro LED/Micro OLED 的晶圆显示 AOI 检测设备、模组系统级检测设备、老化设备、信号发生器等产品，并实现量产销售。

此外，公司知识产权由 2023 年末的 355 项增加至 2025 年末的超过 500 项，其中，发明专利由 42 项增加至 173 项。该等研发成果为公司未来的发展打下坚实基础，将助力公司长期可持续发展。

C. 与主要客户建立了长期稳固的战略合作伙伴关系，在手订单充足

报告期内，公司积极推进客户开发与维护，与长鑫科技等国内头部半导体存储厂商及京东方、TCL、维信诺等新型显示制造厂商建立了长期稳固的战略合作关系。公司核心产品已应用于国内头部半导体厂商及新型显示制造厂商生产线，在市场上具有较强的竞争力，助力客户在降低测试成本、逐步实现供应链国产替代的同时提升生产质量，获得了客户的广泛认可。截至 2026 年 3 月 31 日，公司在手订单规模持续处于较高水平。

因此，报告期内，发行人与主要客户合作稳定、下游需求旺盛、在手订单充足，营业收入增长具备合理性。

③公司主要产品类型的收入、销量及销售单价变化情况

A. 半导体存储器件测试

报告期内，公司半导体存储器件测试业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 12.81%、31.09%及 55.51%，是公司主营业务收入的主要来源。

报告期内，公司半导体存储器件测试业务主要包括芯片测试机及探针卡，合计销售金额为 67,652.85 万元，占报告期内半导体存储器件测试合计销售额的比重为 70.70%。

a. 芯片测试机。报告期内，公司芯片测试机销售收入及销售数量呈现快速增长，主要系公司在产品技术不断发展的基础上成功导入战略客户。报告期内，公司芯片测试机单位售价存在一定波动，主要系受以下因素的综合影响：（1）销售的产品配置存在差异。（2）定价策略存在一定差异。报告期内，产品价格波动有其特定商业背景，不存在重大异常情况。

b. 探针卡。报告期内，随着公司半导体业务规模的扩大，探针卡的销售收入及销售数量均有所增长。报告期内，公司探针卡销售单价存在一定波动主要系结合市场竞争情况、订单规模及客户合作关系等因素对定价策略进行了相应的调整，不存在异常情况。

B. 新型显示器件检测

报告期内，公司新型显示器件检测业务主要产品包括 Cell 老化设备、Cell 光学检测设备及 Module 光学检测设备等，报告期内上述产品合计销售金额为 111,920.94 万元，占报告期内新型显示器件检测业务合计销售额的比重为 69.17%。上述细分类别产品销售收入、数量及单价变化原因如下：

a. Cell 老化设备

报告期内，公司 Cell 老化设备分别实现销售收入 6,731.06 万元、7,919.06 万元及 21,886.20 万元，收入规模及销售数量有所上升。

报告期内，公司 Cell 老化设备销售单价存在一定波动，2025 年 Cell 老化设备销售单价较高主要系当年公司 Cell 老化设备相关产品技术规格难度较高，单价较高，导致销售单价有所增长。

b. Cell 光学检测设备

报告期内，公司 Cell 光学检测设备分别实现销售收入 25,163.27 万元、12,529.04 万元及 6,119.24 万元，收入规模及销售数量有所下降，主要系受下游消费电子市场景气度影响，客户产线投产进度出现减缓，导致 Cell 光学检测设备收入规模有所下降。

报告期内，公司 Cell 光学检测设备销售单价存在一定波动，主要系销售的产品存在差异。公司 Cell 光学检测设备根据产品检测自动化程度可进一步划分为全自动 Cell 光学检测设备、半自动 Cell 光学检测设备及手动 Cell 光学检测设备。2024 年公司销售的产品中包含部分单价较低的手动 Cell 光学检测设备，导致当年单价整体呈现下降趋势；2025 年，公司销售的产品主要为全自动 Cell 光学检测设备，且技术规格定制化程度较高，相应单价较高，导致当年销售单价有所增长。

c. Module 光学检测设备

报告期内，公司 Module 光学检测设备分别实现销售收入 6,940.03 万元、17,588.24 万元及 7,044.80 万元，销售收入及数量存在一定波动，主要系随着下游客户模组产线建设阶段变化，公司销售的产品有所不同，导致相应设备销售规模有所波动。

报告期内，公司 Module 光学检测设备销售单价存在一定波动，主要系该产品定制化程度较高，客户需求不同进而导致销售的产品单价存在一定波动。2025 年 Module 光学检测设备销售单价较高主要系当年销售的产品技术规格难度较高，单价较高，导致销售单价有所增长。

综上所述，报告期内，公司最主要产品的销售规模及销售数量受客户产线建设需求及下游市场景气度等因素的综合影响，销售单价主要系受产品、客户定制化需求等因素的综合影响，有其合理性，不存在重大异常情况。

(3) 净利润波动影响因素及合理性分析

报告期内，公司净利润波动与毛利、期间费用及其他损益科目变动的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	112,806.11	80,312.97	64,856.33
营业收入同比增长	40.46%	23.83%	\
综合毛利率	36.73%	32.82%	37.86%
期间费用	29,220.42	18,296.71	14,333.39
期间费用同比增长	59.70%	27.65%	\
净利润增加额	-971.48	-3,222.60	\
营业毛利增加对净利润的影响	15,078.96	1,803.39	\
期间费用增加对净利润的影响	-10,923.71	-3,963.32	\
其中：销售费用对净利润的增加额	-1,270.55	788.57	\
管理费用对净利润的增加额	-2,690.86	-658.08	\
研发费用对净利润的增加额	-7,343.04	-3,783.77	\
其他损益对净利润的影响	-4,464.32	-3,121.27	\

报告期内，公司净利润波动主要受毛利及期间费用的波动影响，其中，毛利对公司净利润的提升整体与收入增长趋势一致，不存在异常波动情况。然而，期间费用增长速度快于营业收入增长的情况在一定程度上抑制了净利润的改善。其中，期间费用的增加主要源于研发费用的增加。在此背景下，期间费用，尤其是研发费用的增长部分抵消了营业收入及毛利增长对业绩的影响，导致公司业绩存在一定波动。

①毛利波动情况及合理性分析

报告期内，公司主营业务分产品类型的毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
半导体存储器件测试	17,645.85	28.26%	8,076.69	32.38%	2,225.62	26.84%
新型显示器件检测	23,653.30	47.25%	18,207.37	32.93%	22,262.52	39.43%
合计	41,299.15	36.71%	26,284.06	32.76%	24,488.14	37.82%

注：毛利率合计数为主营业务毛利率。

由上可见，公司主营业务毛利随着销售规模增长而呈现相应增长，在毛利率相对稳定的背景下，报告期内，公司毛利总体呈现出持续上涨趋势，毛利增幅与营业收入增幅基本相当，不存在异常波动情况。

其中，半导体存储器件测试产品毛利占比稳步提升，主要系受半导体存储器件测试业务收入占主营业务比重稳步提升的影响。未来随着公司产品和技术不断的创新升级迭代、产品日趋丰富及规模经济逐步体现，公司相关业务盈利水平将稳步提升。

与此同时，公司新型显示器件检测业务毛利水平整体较为稳定，是公司毛利的主要来源之一。报告期内，新型显示器件检测业务收入毛利率存在一定波动，其中，2025 年度相较于 2024 年度略有所上升主要系公司产品验证及战略客户开发取得积极进展，产生了较好的经济效益。

②期间费用变动原因及合理性情况

报告期内，公司期间费用随着业务收入规模增长呈现出相应增长，其中以研发费用增长较为显著。具体分析如下：

A. 研发费用波动原因及合理性情况

报告期内，公司研发投入维持在较高的水平，公司各期研发费用及占收入比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,251.27	55.98%	7,193.04	65.58%	4,481.52	62.37%
材料费	3,176.85	17.35%	1,023.94	9.34%	987.27	13.74%
折旧与摊销	1,749.32	9.55%	1,015.93	9.26%	599.28	8.34%
股份支付	905.16	4.94%	-	-	-	-
技术开发费	851.68	4.65%	889.27	8.11%	563.22	7.84%
差旅费	765.99	4.18%	518.09	4.72%	354.08	4.93%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁水电物管费	303.26	1.66%	78.01	0.71%	98.43	1.37%
知识产权费	137.65	0.75%	122.37	1.12%	18.67	0.26%
其他	170.63	0.93%	128.14	1.17%	82.54	1.15%
合计	18,311.81	100.00%	10,968.77	100.00%	7,185.00	100.00%
占营业收入比重	16.23%		13.66%		11.08%	

由上可见，公司研发费用呈现出快速增长，主要与公司主营业务所处的行业有直接关系。公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，需要持续研发以保持产品技术优势并巩固行业领先地位。报告期内，公司为了持续推动半导体存储器业务的快速发展，公司加大了研发投入水平。一方面，报告期内公司研发人员数量有所增长，由 2023 年末的 190 人增加至 2025 年末的 437 人，进而导致研发费用中职工薪酬及相关支出均随之有所增加；另一方面，2025 年，公司制定并实施了《2025 年限制性股票激励计划》，亦导致研发费用中的股份支付费用有所增加。

报告期内，公司持续加大研发投入，全方位提高公司核心竞争优势，研发费用率有所提高，公司研发投入水平与同行业可比公司相比不存在显著异常情况。2025 年，公司研发费用率略低于精测电子，高于华兴源创，与长川科技、华峰测控基本相当，具体见下表所示：

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长川科技	17.69%	26.55%	40.31%
华峰测控	19.74%	19.04%	19.10%
精测电子	24.25%	28.23%	26.37%
华兴源创	15.70%	21.62%	21.34%
平均值	19.34%	23.86%	26.78%
精智达	16.23%	13.66%	11.08%

未来，随着重点研发项目及其产业化应用有序推进，公司收入规模将持续扩大，研发投入强度将趋于稳定状态。

B. 管理费用波动原因及合理性情况

报告期内，公司各期管理费用主要项目及所占比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,354.09	50.70%	2,109.59	53.75%	1,385.61	42.41%
股份支付	942.64	14.25%	204.65	5.21%	398.76	12.21%
折旧与摊销	679.75	10.27%	282.41	7.20%	260.26	7.97%
中介机构服务费	510.40	7.71%	382.37	9.74%	295.60	9.05%
办公劳保通讯费	333.25	5.04%	169.07	4.31%	174.52	5.34%
差旅费	275.03	4.16%	154.91	3.95%	117.70	3.60%
租赁水电物管费	154.07	2.33%	59.93	1.53%	60.72	1.86%
业务招待费	131.82	1.99%	242.87	6.19%	204.14	6.25%
其他	234.69	3.55%	319.07	8.13%	369.50	11.31%
合计	6,615.74	100.00%	3,924.88	100.00%	3,266.80	100.00%
占营业收入比重	5.86%		4.89%		5.04%	

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付以及折旧摊销费等构成。2025 年，公司发生管理费用 6,615.74 万元，较上年同比增长 68.56%。其中，2025 年度职工薪酬有所增长，主要系受随着公司经营规模不断扩大，公司管理人员数量及平均薪酬相应增加所致；管理费用中股份支付费用亦有所增长，主要系 2025 年公司制定并实施了《2025 年限制性股票激励计划》，股份支付费用有所增加。折旧与摊销及办公劳保通讯费整体规模有所上升主要系随着公司经营规模持续扩大影响所致，不存在重大异常情况。

与此同时，报告期内，公司管理费用占营业收入比重相对稳定，不存在异常波动情况。

C. 销售费用波动原因及合理性情况

报告期内，公司销售费用构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,261.26	60.28%	2,810.87	67.90%	3,239.61	65.74%
市场推广费	666.04	12.31%	171.83	4.15%	563.61	11.44%
差旅费	385.41	7.12%	405.90	9.81%	517.22	10.50%
招待费	345.19	6.38%	316.09	7.64%	242.99	4.93%
租赁水电物管费	280.53	5.19%	202.72	4.90%	253.07	5.14%
折旧与摊销	142.10	2.63%	91.28	2.21%	50.33	1.02%
股份支付	220.83	4.08%	-	-	-	-
其他	108.83	2.01%	140.94	3.40%	61.37	1.25%
合计	5,410.18	100.00%	4,139.63	100.00%	4,928.20	100.00%
占营业收入比重	4.80%		5.15%		7.60%	

公司销售费用主要由职工薪酬、市场推广费、差旅费等构成。报告期内，公司聚焦管理体系优化，销售人员数量有所减少，导致相应的职工薪酬、差旅费及业务招待费有所下降，不存在重大异常情况。

与此同时，报告期内，公司销售费用占营业收入比重相对稳定，略有下滑，主要系受规模经济的影响，不存在异常波动情况。

③其他损益科目变动情况

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他损益科目金额	-4,803.47	-339.15	2,782.12
其中：信用减值损失金额	-3,598.60	-1,720.88	-639.87

2025 年度，公司其他损益科目涉及的信用减值损失金额有所上升，主要系报告期末的应收账款余额有所增长，相应的应收账款坏账准备亦有所增长，不存在重大异常情况。报告期内，公司应收账款坏账计提比例分别为 8.39%、8.30%及 10.93%，整体处于同行业可比公司的合理范围以内，详见本回复“（二）结合应收账款主要客户销售金额、交易内容、信用政策等，说明应收账款规模持续增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄情况、回款情况、同行业可比公司情况等，

说明坏账准备计提是否充分”之“2、结合应收账款账龄情况、回款金额及回款方式、同行业可比公司情况等，说明坏账准备计提是否充分”。

综上所述，报告期内，公司净利润有所波动主要系受研发投入大及信用损失增加等综合变动所致，具有合理性。

2、相关因素对公司业绩波动具有暂时性影响，与同行业可比公司不存在重大差异

报告期内，公司与同行业可比公司营业收入、净利润比较情况如下：

单位：万元

可比公司	项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	复合增长率
		金额	变动	金额	变动	金额	
长川科技	营业收入	529,154.21	45.31%	364,152.60	105.15%	177,505.49	72.66%
	净利润	134,362.11	187.72%	46,698.15	669.85%	6,065.91	370.64%
华峰测控	营业收入	134,641.06	48.72%	90,534.54	31.05%	69,086.19	39.60%
	净利润	53,609.61	60.55%	33,391.48	32.69%	25,165.23	45.96%
精测电子	营业收入	334,763.76	30.51%	256,507.30	5.59%	242,936.76	17.39%
	净利润	8,408.41	-137.73%	-22,282.97	-349.05%	8,947.18	-3.06%
华兴源创	营业收入	223,953.01	22.88%	182,257.42	-2.07%	186,104.20	9.70%
	净利润	8,008.44	-116.11%	-49,703.74	-307.39%	23,966.80	-42.19%
发行人	营业收入	112,806.11	40.46%	80,312.97	23.83%	64,856.33	31.88%
	净利润	7,003.49	-12.18%	7,974.97	-28.78%	11,197.57	-20.91%

由上可见，2023 年至 2025 年，公司营业收入复合增长率 31.88%，与同行业可比公司整体变动趋势一致。同行业可比公司营业收入与净利润波动趋势不尽相同，与各自具体经营情况有直接关系，公司与同行业可比公司之间不存在显著异常情况；

报告期内，公司净利润存在一定波动，主要系受研发投入增长较多以及现阶段公司营业收入规模相对较小，规模效应尚未充分体现等综合因素影响所致。前述研发投入规模较大对盈利情况的影响因素属于一定时期内暂时性影响因素，对公司生产经营可持续性不构成重大不利影响。未来，随着重点研发项目及其产业

化应用有序推进，公司收入规模将持续扩大，研发投入水平将相对稳定，增幅趋于平稳，并随规模效应逐步体现期间费用率将有所下降，公司盈利水平将得到改善。

此外，根据公司披露的《2026年第一季度报告》，公司2026年一季度主要财务数据已呈现积极改善态势，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026年一季度	2025年一季度	变动比例
营业收入	33,288.12	15,211.15	118.84%
净利润	2,700.05	-1,631.01	\
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	1,247.16	-1,802.98	\

由上可见，2026年一季度，公司实现营业收入33,288.12万元，同比增长118.84%，经营规模持续向好，主要得益于半导体测试设备的快速放量与市场突破；公司实现归属于上市公司股东的净利润1,455.06万元，较上年同期增长3,076.64万元，盈利水平亦有较大改善。报告期内，业绩波动的影响因素对公司长期业绩情况不构成重大不利影响。此外，在手订单金额持续增长，为公司收入的持续增长提供了保障。

综上所述，随着公司业绩规模持续增长、研发费用投入占收入比重趋于稳定以及规模经济效应逐步体现，未来公司盈利水平将趋于改善态势，具体盈利规模将主要受收入规模增速、重点研发项目产业化情况以及产品市场拓展等因素的综合影响。

公司本次募集资金投资项目中存在一定规模的研发费用支出。对于募投项目新增研发费用对公司利润的风险，公司已在募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”之“(四)募投项目新增研发费用影响公司利润的风险”进行以下风险提示：

“(四)募投项目新增研发费用影响公司利润的风险”

公司本次募集资金投资项目中存在较大规模研发费用支出。虽然公司已对本

次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证，预计项目产生的效益能够充分消化新增研发费用，但若因市场环境等因素发生变化，募投项目产能消化不及预期，导致募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增研发费用可能影响公司利润，从而导致未来经营业绩存在下降的风险。”

(二) 结合应收账款主要客户销售金额、交易内容、信用政策等，说明应收账款规模持续增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄情况、回款情况、同行业可比公司情况等，说明坏账准备计提是否充分

1、结合应收账款主要客户销售金额、交易内容、信用政策等，说明应收账款规模持续增长的原因及合理性

(1) 公司应收账款主要客户销售金额、交易内容、信用政策

报告期各期末，公司应收账款主要客户的销售金额、交易内容、信用政策等情况具体如下：

单位：万元

期间	客户名称	期末余额	占应收账款余额比重	当期销售金额	主要交易内容	主要信用政策
2025年	已申请豁免披露	25,745.09	40.47%	37,198.58	新型显示器件检测产品	已申请豁免披露
		11,925.76	18.75%	59,966.24	半导体存储器件测试产品	
		8,182.53	12.86%	3,294.41	新型显示器件检测产品	
		3,984.39	6.26%	891.85	新型显示器件检测产品	
		3,759.56	5.91%	2,926.65	新型显示器件检测产品	
	合计	53,597.33	84.26%	104,277.73	/	/
2024年	已申请豁免披露	8,382.98	19.05%	13,063.16	新型显示器件检测产品	已申请豁免披露
		8,314.81	18.90%	13,973.84	半导体存储器件测试产品	
		7,449.53	16.93%	9,398.60	半导体存储器件测试产品	
		6,029.69	13.70%	7,582.91	新型显示器件检测产品	
		5,857.05	13.31%	8,730.84	新型显示器件检测产品	

期间	客户名称	期末余额	占应收账款余额比重	当期销售金额	主要交易内容	主要信用政策
	合计	36,034.06	81.89%	52,749.36	/	/
2023年	已申请豁免披露	5,959.11	24.87%	8,408.17	新型显示器件检测产品	已申请豁免披露
		5,037.43	21.03%	6,705.40	半导体存储器件测试产品	
		4,489.30	18.74%	13,568.18	新型显示器件检测产品	
		3,356.21	14.01%	10,825.00	新型显示器件检测产品	
		2,045.32	8.54%	18,115.74	新型显示器件检测产品	
	合计	20,887.37	87.18%	57,622.50	/	/

注：上述主要交易内容和主要信用政策为公司与相应客户的主要合同的相关内容。

由上可见，公司应收账款主要客户的主要交易内容涉及半导体存储器件测试产品和新型显示器件检测产品，未发生重大不利变化。

报告期内，公司与主要客户之间的信用政策未发生重大不利变化，主要分为到货、验收以及质保等付款节点并实行分阶段付款，符合业务特点和行业惯例。

（2）报告期内公司应收账款规模持续增长的原因及合理性

报告期各期末，公司应收账款和营业收入的情况具体如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2024年度
应收账款账面余额	63,607.62	44,001.31	23,957.65
营业收入	112,806.11	80,312.97	64,856.33
应收账款账面余额占营业收入比例	56.39%	54.79%	36.94%
其中：新型显示器件检测业务主要客户期末余额	41,671.57	20,269.72	15,849.94
其中：新型显示器件检测业务主要客户期末余额占应收账款余额占比	65.51%	46.07%	66.16%

由上可见，报告期各期末，应收账款期末余额稳步增长，主要系受以下几方面因素的影响：

①随着公司业务规模的上升，应收账款相应增长。公司客户普遍采用分阶段

结算的模式，涉及到货、验收以及质保等付款节点，导致公司应收账款余额随着收入的增长而增长。报告期内，公司营业收入由 64,856.33 万元增长至 112,806.11 万元，呈现出高速增长，进而带动各期末应收账款相应增加。

②新型显示器件检测业务部分客户因付款周期延长导致报告期末应收账款增长幅度高于收入增长幅度，进而导致各期应收账款余额占当期收入比重有所增加。新型显示行业受下游消费电子市场需求影响较大，行业景气度高低会对新型显示检测行业客户的付款周期有一定影响。报告期内，新型显示行业处于复苏过程中，行业景气度不高使得下游客户付款周期有所延长，进而导致公司应收账款余额有所增长。

综上所述，报告期末公司应收账款期末余额较大，主要系受业务规模持续上升及部分客户自身付款安排有所延长的影响，不存在重大异常情况，符合公司业务实际及行业特性，具有合理性。

2、结合应收账款账龄情况、回款金额及回款方式、同行业可比公司情况等，说明坏账准备计提是否充分

(1) 应收账款账龄情况

①应收账款账龄情况

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	44,605.45	70.13%	37,180.14	84.50%	20,805.47	86.84%
1至2年	15,357.49	24.14%	5,839.34	13.27%	2,578.75	10.76%
2至3年	3,208.31	5.04%	569.53	1.29%	130.42	0.54%
3至4年	357.28	0.56%	79.09	0.18%	201.60	0.84%
4至5年	79.09	0.12%	201.60	0.46%	163.24	0.68%
5年以上	-	0.00%	131.61	0.30%	78.18	0.33%
小计	63,607.62	100.00%	44,001.31	100.00%	23,957.65	100.00%

账龄	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
减：坏账准备	6,950.01	/	3,651.17	/	2,010.89	/
合计	56,657.61	/	40,350.14	/	21,946.76	/

由上可见，报告期内，公司应收账款账龄主要集中在1年以内，各期占比分别为86.84%、84.50%及70.13%，公司应收账款账龄结构良好。2025年末，公司1年以上的应收账款占比有所增长，主要系新型显示行业尚处于复苏期，下游客户由于自身付款安排原因，回款周期有所延长所致。公司前述主要客户均为半导体或显示行业龙头企业，经营规模较大、信用状况良好，公司与其合作较久，其生产经营未发生重大不利变化，其应收账款信用风险未发生显著不利变化，不存在重大回收风险，故报告期内，前述客户均不涉及需要单项计提坏账准备的情况。

②应收账款账龄结构与同行业对比情况

与同行业可比公司相比，公司整体账龄结构处于行业合理水平，不存在显著差异。公司应收账款账龄结构与同行业对比情况如下：

公司名称	账龄	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
华峰测控	1年以内	90.04%	83.12%	82.31%
	1-2年	7.61%	11.10%	12.88%
	2-3年	0.97%	5.30%	4.41%
	3年以上	1.38%	0.49%	0.40%
	小计	100.00%	100.00%	100.00%
长川科技	1年以内	97.59%	88.64%	89.67%
	1-2年	1.79%	7.63%	9.82%
	2-3年	0.44%	3.60%	0.40%
	3年以上	0.18%	0.13%	0.11%
	小计	100.00%	100.00%	100.00%
精测电子	1年以内	81.49%	72.20%	73.03%
	1-2年	9.60%	13.55%	17.22%

公司名称	账龄	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
	2-3年	3.50%	6.05%	5.97%
	3年以上	5.41%	8.20%	3.77%
	小计	100.00%	100.00%	100.00%
华兴源创	1年以内	70.55%	71.74%	74.60%
	1-2年	16.21%	17.81%	21.07%
	2-3年	7.55%	8.55%	2.46%
	3年以上	5.70%	1.90%	1.87%
	小计	100.00%	100.00%	100.00%
平均值	1年以内	84.92%	78.92%	79.90%
	1-2年	8.80%	12.52%	15.25%
	2-3年	3.12%	5.88%	3.31%
	3年以上	3.17%	2.68%	1.54%
	小计	100.00%	100.00%	100.00%
发行人	1年以内	70.13%	84.50%	86.84%
	1-2年	24.14%	13.27%	10.76%
	2-3年	5.04%	1.29%	0.54%
	3年以上	0.69%	0.94%	1.85%
	小计	100.00%	100.00%	100.00%

报告期各期末，公司与同行业可比公司应收账款账龄结构基本相当，均以1年以内为主，整体占应收账款总额的70%以上。公司1年以内应收账款情况与精测电子和华兴源创基本相当，略低于华峰测控、长川科技，与各公司主营业务结构及客户结构不同有一定关系，不存在重大异常情况。

③长账龄应收账款及回款情况

截至2025年12月31日，公司应收账款中存在部分长账龄的逾期款项情况。截至报告期末，公司信用期外（逾期）应收账款金额为22,714.45万元，占期末应收账款余额的比例为35.71%；公司信用期外（逾期）的应收账款集中于1年以上，1年以上应收账款均为逾期应收账款，占期末信用期外（逾期）应收账款

的比例为 83.66%。公司信用期外应收账款主要客户的具体情况如下：

A. 账龄 1 年以内信用期外应收账款主要客户情况

公司名称	信用期外应收账款金额	期后回款情况	坏账计提金额	2025 年度该客户回款情况
已申请豁免披露	1,636.20	1,272.60	81.81	已申请豁免披露
已申请豁免披露	1,052.34	-	52.62	已申请豁免披露
已申请豁免披露	542.97	163.85	27.15	已申请豁免披露
合计	3,231.51	1,436.45	161.58	已申请豁免披露
占 1 年以内信用期外应收账款比例	87.05%			

注 1：期后回款为截至 2026 年 4 月末逾期应收账款的回款情况，下同。

注 2：上述客户为合并口径，下同；

B. 账龄 1-2 年应收账款主要客户情况

单位：万元

公司名称	1-2 年应收账款金额	期后回款情况	坏账计提金额	2025 年度该客户回款情况
已申请豁免披露	3,775.88	-	755.18	已申请豁免披露
已申请豁免披露	3,571.02	1,110.20	714.2	已申请豁免披露
已申请豁免披露	3,011.38	-	602.28	已申请豁免披露
已申请豁免披露	2,230.31	294.03	446.06	已申请豁免披露
已申请豁免披露	1,061.59	1,061.59	212.32	已申请豁免披露
合计	13,650.19	2,465.82	2,730.04	已申请豁免披露
占 1-2 年应收账款余额比例	88.88%			

C. 账龄 2-3 年应收账款主要客户情况

单位：万元

公司名称	2-3 年应收账款金额	期后回款情况	坏账计提金额	2025 年度该客户回款情况
已申请豁免披露	833.89	-	333.56	已申请豁免披露

公司名称	2-3 年应收账款金额	期后回款情况	坏账计提金额	2025 年度该客户回款情况
已申请豁免披露	765.46	63.28	306.18	已申请豁免披露
已申请豁免披露	673.23	221.48	269.29	已申请豁免披露
已申请豁免披露	483	-	193.2	已申请豁免披露
已申请豁免披露	431.94	-	172.78	已申请豁免披露
合计	3,187.53	284.76	1,275.01	已申请豁免披露
占 2-3 年应收账款余额比例	99.35%			

由上可见，报告期末，公司应收账款账龄相对较长的客户以显示业务客户为主，相关客户均为行业内知名客户，历史上均未发生坏账的情况。

④前述长账龄应收账款涉及的主要客户情况及坏账风险情况

前述主要长账龄应收账款客户均为行业内知名客户，生产经营情况良好，不存在重大不利变化的情况。新型显示行业受下游消费电子市场需求影响较大，行业景气度高低会对新型显示检测行业客户的付款周期有一定影响，相关情况符合行业情况，不存在重大异常情况。

报告期内，公司与相关客户均建立了长期友好的合作关系，客户资信情况良好，主要客户存在持续回款的情况，不存在恶意拖欠货款或财务风险显著增高等明确可识别特征，不存在需单项计提坏账准备的情况，公司应收账款回收情况整体不存在较大风险。

(2) 应收账款回款情况

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	63,607.62	44,001.31	23,957.65
期后回款金额	14,631.90	34,714.80	23,491.80
期后回款比例	23.00%	78.89%	98.06%

截至 2026 年 4 月 30 日，公司报告期各期末应收账款的期后回款比例分别为 98.06%、78.89%和 23.00%，回款情况整体良好，不存在异常情况。其中，2025 年应收账款期后回款比例较低，主要系受回款统计时间较短的影响；2024 年应收账款期后回款比例低于 80%，主要系新型显示行业尚处于复苏期，部分下游客户由于自身付款安排原因，回款周期有所延长所致。

报告期内，公司应收账款未回款的主要客户均为行业龙头企业，经营规模较大、资信状况良好，公司与其合作年限较长，历史上未发生重大违约情况，公司应收账款发生重大坏账的风险相对较低。

(3) 应收账款坏账计提情况以及同行业可比公司情况

报告期内，对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

报告期各期末，公司应收账款坏账计提情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	63,607.62	44,001.31	23,957.65
坏账准备	6,950.01	3,651.17	2,010.89
坏账准备计提比例	10.93%	8.30%	8.39%

报告期内，公司账龄组合坏账计提比例政策与同行业对比情况如下：

账龄	华峰测控	长川科技	精测电子	华兴源创	平均值	发行人
1 年以内	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1-2 年	30%	10%	10%	10%	15%	20%
2-3 年	70%	20%	15%	30%	34%	40%
3-4 年	100%	40%	20%	50%	53%	80%
4-5 年	100%	80%	50%	80%	78%	100%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%

报告期各期末，公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
华峰测控	8.84%	11.68%	11.47%
长川科技	5.23%	6.09%	6.04%
精测电子	8.58%	8.73%	7.38%
华兴源创	10.71%	9.27%	8.12%
平均值	8.34%	8.94%	8.25%
精智达	10.93%	8.30%	8.39%

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 8.39%、8.30%及 10.93%，整体处于同行业可比公司的合理范围内，不存在显著异常情况。

从坏账计提政策来看，公司采用的账龄组合计提比例在 1-2 年及 2-3 年账龄段高于同行业平均水平，体现出更为审慎的坏账准备计提策略。从实际计提结果来看，2023 年末及 2024 年末公司坏账准备计提比例与同行业平均值基本持平，2025 年末因公司 1 年以上应收账款占比有所上升，而公司对长账龄应收款项执行更为严格的计提标准，使得坏账准备计提比例相应提升，高于同行业平均值。

综上所述，公司坏账准备计提政策是审慎、合理的，实际计提比例处于行业合理水平，与自身应收账款结构变化相匹配，坏账准备计提充分、合理。

（三）结合存货构成、库龄、订单覆盖率、期后销售情况等，说明公司存货跌价准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异

1、存货构成基本情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	8,733.35	37.50%	7,908.09	50.51%	6,005.49	23.23%
在产品	4,018.21	17.25%	2,218.67	14.17%	3,283.96	12.70%
库存商品	3,444.60	14.79%	376.94	2.41%	872.93	3.38%

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
发出商品	4,858.21	20.86%	4,966.14	31.72%	15,076.91	58.31%
合同履行成本	527.50	2.27%	75.17	0.48%	208.49	0.81%
委托加工物资	1,706.32	7.33%	112.77	0.72%	408.55	1.58%
合计	23,288.18	100.00%	15,657.78	100.00%	25,856.32	100.00%

报告期各期末，公司存货结构以原材料、在产品、库存商品以及发出商品为主，占期末存货的90%以上，整体不存在异常波动情况。其中：（1）原材料占比先上升后下降，主要系2024年公司为应对半导体存储器件测试业务旺盛增长的交付需求，公司原材料采购规模有所增加，导致当年原材料占比升至50.51%，2025年随着领用消耗，原材料占比相应回落；（2）2025年末，公司库存商品有所增长，主要系采购原材料转化为库存商品；（3）发出商品占比逐年稳步下降，主要系报告期内，公司业务规模呈现快速增长，公司下游客户的旺盛需求使得发出商品陆续完成验收所致。

2、存货库龄情况

报告期各期末，存货库龄情况如下：

单位：万元

库龄	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	17,998.96	77.29%	13,627.17	87.03%	18,798.33	72.70%
1-2年	4,613.50	19.81%	570.16	3.64%	6,131.50	23.71%
2-3年	298.62	1.28%	1,143.82	7.31%	563.92	2.18%
3年以上	377.11	1.62%	316.64	2.02%	362.58	1.40%
合计	23,288.19	100.00%	15,657.79	100.00%	25,856.33	100.00%

报告期各期末，公司存货库龄以一年以内为主，占比分别为72.70%、87.03%及77.29%，存货库龄情况良好，不存在异常情况。

报告期各期末，公司存货结构以原材料、在产品、库存商品以及发出商品为主，占期末存货的90%以上。结合存货类别与主营业务类型的对应情况，对报告

期末在产品、库存商品及发出商品等主要存货整体库龄情况按照主营业务情况进行分析，具体情况如下表所示：

万元

2025年12月31日						
项目	1年以内		1年以上		合计	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体存储器件测试	7,288.87	87.92%	3,865.93	95.92%	11,154.80	90.53%
新型显示器件检测	1,001.82	12.08%	164.40	4.08%	1,166.22	9.47%
小计	8,290.69	100.00%	4,030.33	100.00%	12,321.02	100%
2024年12月31日						
项目	1年以内		1年以上		合计	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体存储器件测试	6,561.69	97.22%	448.79	55.24%	7,010.48	92.71%
新型显示器件检测	187.67	2.78%	363.60	44.76%	551.27	7.29%
小计	6,749.36	100.00%	812.39	100.00%	7,561.75	100%
2023年12月31日						
项目	1年以内		1年以上		合计	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体存储器件测试	984.79	7.42%	576.95	9.67%	1,561.74	8.12%
新型显示器件检测	12,283.12	92.58%	5,388.93	90.33%	17,672.05	91.88%
小计	13,267.91	100.00%	5,965.88	100.00%	19,233.79	100%

注 1：上述金额为在产品、库存商品及发出商品不含存货跌价准备的余额；

注 2：公司按照初始入库时点或投产时点开始连续计算存货库龄

由上可见，半导体存储器件测试设备业务和新型显示器件检测业务的上述主要存货呈现不同特点，具体为：（1）半导体存储器件测试设备主要存货规模随着半导体存储器件测试设备快速发展呈现出稳步增长情况，新型显示器件检测的主要存货规模随着 2023 年末发出商品于 2024 年度完成结转销售而有较大下降。

（2）主营业务的主要存货类型的库龄以 1 年以内为主，整体库龄相对较好，同

时，亦存在一定规模 1 年以上的存货。其中，①2023 年末，公司库龄 1 年以上的存货主要涉及新型显示器件检测业务的发出商品，主要系受客户产线类型、客户投产情况等因素影响导致验收较长，相关发出商品已陆续于 2024 年度结转销售，进而导致 2024 年末 1 年以上发出商品金额有较大下降；②2025 年，公司库龄 1 年以上的存货主要涉及半导体存储器件测试业务，主要为公司相关产品尚处于验收过程中所致，该设备为首次交付验收，验收流程相对较长，进而导致 1 年以上的存货金额有所增长。公司不同业务的期末主要存货情况符合公司的实际经营情况，并有充足的订单覆盖，不存在重大异常情况。

3、期末在手订单覆盖情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司在产品、库存商品和发出商品的订单覆盖率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
在产品	4,018.21	2,218.67	3,283.96
库存商品	3,444.60	376.94	872.93
发出商品	4,858.21	4,966.14	15,076.91
合计	12,321.02	7,561.75	19,233.80
订单覆盖金额	11,458.16	7,056.15	18,625.14
订单覆盖率	93.00%	93.31%	96.84%

注：期末订单覆盖率=订单覆盖的存货余额/存货期末余额，存货期末账面余额为在产品、库存商品及发出商品的账面余额，不含存货跌价准备。

报告期各期末，公司在产品、库存商品及发出商品订单覆盖率分别为 96.84%、93.31%及 93.00%，始终维持在 90%以上的较高水平。公司主要存货均有明确的销售订单支持，存货积压风险相对较低。整体来看，公司存货不存在显著的跌价的风险。

4、存货期后销售情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司存货期后销售情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
在产品	4,018.21	2,218.67	3,283.96
库存商品	3,444.60	376.94	872.93
发出商品	4,858.21	4,966.14	15,076.91
合计	12,321.02	7,561.75	19,233.80
期后销售金额	5,061.34	4,898.90	18,004.62
期后销售比例	41.08%	64.79%	93.61%

注：期后销售金额=期后销售存货对应的期末存货余额，存货期末账面余额为在产品、库存商品及发出商品的账面余额，不含存货跌价准备。

报告期各期末，公司在产品、库存商品及发出商品期后销售比例分别为 93.61%、64.79%和 41.08%。其中，2024 年末尚未结转销售的存货目前已取得客户意向订单；2025 年末存货期后销售情况良好，主要系下游客户交付需求旺盛增长。报告期内，公司存货期后销售整体情况良好，不存在重大异常情况。

5、同行业可比公司存货跌价计提情况

报告期各期末，公司存货跌价计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
华峰测控	1.81%	2.27%	2.24%
长川科技	5.80%	5.95%	4.67%
精测电子	4.11%	1.10%	0.74%
华兴源创	12.99%	11.35%	10.63%
平均值	6.18%	5.17%	4.57%
发行人	9.82%	8.77%	8.12%

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为 8.12%、8.77%及 9.82%，高于华峰测控、长川科技、精测电子以及同行业可比公司平均水平，低于华兴源创，主要系公司及同行业可比公司之间在期末存货结构、存货库龄情况、客户及

所处细分行业等方面存在一定差异，进而导致存货跌价计提比例不尽相同。总体而言，以显示面板检测设备为主的公司存货跌价准备计提比例整体高于以半导体测试设备为主的公司。例如，华兴源创以显示面板检测设备为主，华峰测控和长川科技均以半导体测试设备为主，前者存货跌价准备计提比例显著高于华峰测控和长川科技。

报告期内，公司聚焦于半导体测试及新型显示器件检测领域，主营业务涉及半导体测试设备和新型显示面板检测设备两部分。报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例介于华兴源创与长川科技及华峰测控之间的合理水平，且整体变化趋势与同行业可比公司基本一致，不存在显著异常情况。

报告期各期末，公司严格按照成本与可变现净值对存货进行减值测试，并按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备期末余额主要构成情况如下表所示：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价准备占期末存货余额比例	9.82%	8.77%	8.12%
其中：原材料存货跌价准备占期末存货余额比例	2.38%	6.16%	1.84%
库存商品存货跌价准备占期末存货余额比例	3.09%	1.95%	1.74%
发出商品存货跌价准备占期末存货余额比例	1.03%	0.59%	3.40%
小计	6.50%	8.70%	6.98%

由上可见，报告期各期末，公司期末存货跌价准备占期末存货余额的比例整体比较稳定，略有上升，主要原因涉及以下方面：（1）与 2023 年度相比，2024 年度存货跌价准备占期末存货余额比例有所上升主要系公司为保障生产供应稳定性而集中采购的一批芯片类原材料因领用进度不及预期，导致当期原材料跌价准备计提金额有所提升所致；（2）与 2024 年度相比，2025 年度存货跌价准备占期末存货余额比例有所上升主要系部分显示检测产品等因其成本高于可变现净值而产生的存货跌价准备较多，进而导致当期库存商品存货跌价准备占期末存货余额比例有所上升。报告期内，公司存货跌价准备计提是谨慎且充分的，符合公司的实际经营情况，不存在重大异常情况。

综上所述，报告期内，公司存货库龄状况良好，库龄以 1 年以内为主，不存在重大异常情况；公司存货订单覆盖比例较高，期后结转销售情况良好。公司存货跌价准备计提充分，与同行业可比公司相比不存在重大异常情况。

（四）截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

1、财务性投资及类金融业务的认定标准

根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，对财务性投资和类金融业务的界定标准及相关规定如下：

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。金额较大是指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

2、截至最近一期末公司持有的对外投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外投资的相关科目列示如下：

单位：万元

序号	项目	金额	是否包含财务性投资
1	交易性金融资产	25,039.33	否
2	其他应收款	543.59	否
3	一年内到期的非流动资产	3,253.53	否
4	其他流动资产	3,197.82	否
5	长期股权投资	5,941.69	否

序号	项目	金额	是否包含财务性投资
6	其他非流动金融资产	41.91	否
7	其他非流动资产	22,875.19	否

(1) 交易性金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产主要为低风险、流动性好的理财产品，不属于财务性投资。

(2) 其他应收款

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要系押金保证金等，不属于财务性投资。

(3) 一年内到期的非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产主要系一年内到期的大额存单，不属于财务性投资。

(4) 其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他流动资产主要系增值税留抵扣额、以抵销后净额列示的所得税预缴税额、待摊费用等，不属于财务性投资。

(5) 长期股权投资

截至 2025 年 12 月 31 日，公司长期股权投资为对联营企业珠海冠中、深圳高铂的投资。其中，珠海冠中主营业务为集成电路测试系统的研制、生产制造、销售服务，报告期内，公司与珠海冠中已开展相关业务合作，合计交易金额为 477.88 万元；深圳高铂主营业务为集成电路测试设备芯片设计与销售，报告期内，公司与深圳高铂已开展相关业务合作，合计交易金额为 2,708.89 万元。上述股权投资与公司主营业务具有较强的协同性，符合公司战略发展方向，不属于财务性投资。

(6) 其他非流动金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动金融资产主要系公司于 2023 年 4 月与联营企业珠海冠中签订了附有回购条款的股东协议，根据《企业会计准则》规定该股权投资回购权计入其他非流动金融资产。该股权投资是公司基于自身的发展战略围绕主营业务进行的投资，不属于财务性投资。

(7) 其他非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产主要系预付购买软件、固定资产款项、预付装修款、预付战略投资款及长期大额存单。其中，预付战略投资款系公司预付给杭州灵伴科技有限公司的战略投资款，杭州灵伴科技有限公司主要从事 AR 眼镜等人机交互智能产品的研发、销售，上述股权投资系公司围绕主营业务和产业链上下游进行的投资，不属于财务性投资。

综上所述，截至最近一期末，公司不存在财务性投资。

3、本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月（即 2025 年 8 月 27 日）起至今，发行人拟实施的对外投资不涉及财务性投资或类金融业务的情况，具体对外投资情况如下：

(1) 参与投资上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）

公司作为有限合伙人参与投资成立私募基金上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪兆易”）。截至目前其主要信息如下：

①基本情况

项目	具体情况
基金名称	上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人名称	北京石溪清流私募基金管理有限公司
基金规模（万元）	154,600 万元
成立日期	2026 年 4 月 24 日
主要经营场所	上海市浦东新区大团镇永春东路 10 号 1 幢 3 层 301 室

项目	具体情况
投资范围	合伙企业将主要对集成电路等行业的未上市企业进行投资。

注：上述信息来自天眼查，截至日期 2026 年 5 月 10 日

其中，公司作为石溪兆易之有限合伙人，认缴出资额 5,000 万元。

②投资策略

石溪兆易将主要对集成电路等行业的未上市企业进行投资，其中投资于集成电路领域的投资额不低于基金认缴出资总额的百分之七十（70%），投资阶段为早期企业、中小企业和高新技术企业。

③拟对外投资情况

截至本回复出具日，石溪兆易拟投资企业领域与公司的业务发展将形成相应产业上的协同效应。

因此，发行人参与投资石溪兆易私募基金主要是围绕主营业务和产业链上下游进行的投资，公司通过本次对外投资可借助专业投资机构的行业经验和资源优势，更好地把握新技术、新领域的发展动态和投资机遇，进一步深化产业布局，并促进公司主营业务发展，提升综合竞争实力，符合公司整体经营发展战略目标，不属于财务性投资。

（2）拟参与投资设立创投基金

2026 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司或公司全资子公司拟与关联方深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）全资子公司常州清源时代投资管理有限公司及其他合伙人，共同设立创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创投基金”）。截至目前其主要信息如下：

①基本情况

项目	具体情况
基金名称	创投基金（拟定名，以实际注册登记为准）
基金管理人名称	深圳清源时代

项目	具体情况
基金规模（万元）	20,000 万元（以实际注册登记为准）
成立日期	以实际登记注册为准
投资范围	精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目

注：上述创投基金基本情况以最终募集完成情况及工商登记为准。

其中，公司拟合作投资情况如下：

A. 公司或公司全资子公司拟作为股东出资 310 万元，与深圳清源时代共同设立合资公司，合资公司拟作为普通合伙人出资人民币 1,000 万元；

B. 公司或公司全资子公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5,400 万元，具体金额及比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。

②投资策略

创投基金拟投资领域包括：精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目，聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。

本次投资将借助专业投资机构的经验和资源，加快公司在产业链上下游的布局，为公司挖掘新的业绩增长点，提升公司的整体竞争实力。鉴于本次拟投资主体尚在设立过程中，基于谨慎性考虑，公司将对创投基金的投资认定为财务性投资，已对本次拟使用募集资金投资规模进行了调整。

综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，除上述对外投资外，公司不存在实施或拟实施其他财务性投资（包括类金融投资）的情况，不存在新增或拟新增对金融业务投资的情况，不存在新增或拟新增其他与主营业务无关的股权投资，不存在新增拆借资金、委托贷款的情况，不存在新增或拟购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

二、核查情况

（一）核查程序

针对上述事项，我们主要执行了以下核查程序：

1、访谈公司管理层，了解公司营业收入增长的原因及持续性情况，了解公

公司产品毛利水平的波动原因及合理性；

2、获取发行人报告期内财务报表、各损益科目变动情况等，了解各损益科目变动对扣非后归母净利润的影响，核查并分析期间费用、非经常性损益等科目明细变动的原因及合理性；

3、查阅公司与主要客户签订的销售合同或订单，了解主要客户的信用政策；获取发行人报告期内的应收账款明细表以及销售明细表，对比分析主要客户的应收账款余额与销售金额、交易内容、信用政策之间的匹配关系，分析报告期内公司应收账款增长的合理性；查阅公司应收账款坏账准备计提的相关会计政策及会计估计情况，分析是否符合《企业会计准则》的规定及行业特点；获取公司报告期各期应收账款明细表及账龄明细表、坏账准备计提明细表，评估管理层对于预期信用损失率的确定是否合理，核查应收账款期末余额、期末坏账准备计提金额的准确性；了解应收账款期后回款情况及期后回款率的计算过程并执行分析程序；查阅同行业可比公司公开资料，了解同行业可比公司应收账款坏账准备计提情况，对比分析发行人应收账款坏账准备计提政策的合理性；

4、获取发行人存货明细、收入明细并执行分析程序；查阅公司会计政策，了解存货跌价准备计提方法，分析是否符合《企业会计准则》的规定及行业特点；复核发行人存货跌价准备计算过程；获取发行人报告期各期末存货的订单覆盖情况、期后销售明细表并执行分析程序，分析公司存货跌价准备计提是否充分；查阅同行业可比公司的相关公告，计算存货跌价准备计提比例并与发行人进行对比，分析是否存在重大差异；

5、查阅《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规和规范性文件中关于财务性投资相关的规定，逐项分析核查截至报告期末公司财务性投资情况；

6、查阅公司对外投资相关协议，了解对外投资的背景、目的、形成过程、具体内容，了解公司最近一期末是否持有金额较大的财务性投资，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日公司投入的财务性投资情况以及发行人未来一段时间内财务性投资安排情况。

（二）核查意见

经核查，我们认为：

1、报告期内，公司净利润有所波动主要系受营业毛利、期间费用等变动综合所致。报告期内，公司营业收入及毛利均有所增长，公司期间费用随着业务规模扩大呈现出相应增长，其中，又以研发费用增长较为显著和关键。在研发规模相对较大的背景下，研发费用的增长部分抵消了营业收入及毛利增长对业绩的影响，导致报告期内公司净利润有一定波动；

2、发行人报告期内应收账款增长主要系营业收入增长以及部分新型显示器件检测业务客户回款周期有所延长所致；发行人应收账款账龄结构合理，主要集中在1年以内，与同行业可比公司相比不存在重大差异；报告期内，发行人应收账款账龄结构良好，与同行业可比公司相比不存在重大差异；发行人坏账准备计提政策较为审慎，实际计提比例处于行业合理水平，与自身应收账款结构变化相匹配，坏账准备计提是充分的，具有合理性；

3、报告期内，发行人存货构成与其实际经营情况和业务结构相匹配，存货库龄状况良好，库龄以一年以内为主，不存在重大异常情况；报告期内，发行人订单规模充分，存货期后结转销售情况不存在重大异常情况；报告期各期存货跌价计提比例处于同行业可比公司的合理区间范围之内，略高于行业平均水平，具有合理性，发行人存货跌价准备计提是充分和谨慎的；

4、截至最近一期末公司未持有金额较大的财务性投资；自本次发行相关董事会前六个月至今，公司存在对外投资的情况，本次募集资金投资规模已充分根据对外投资的性质进行了谨慎且合理的确定。

（以下无正文）

(本页无正文, 为大华核字[2026]0011006459 号《关于深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



梁梁

中国注册会计师:



陈斌

二〇二六年五月二十八日